

2016年(平成28年)2月1日(月曜日)

日刊



発行所 電波新聞社
東京本社
大阪本社
西部本社

三位一体で事業活性化

千住金属工業

全部門、同じ取り組み・戦略を共有

シナジー効果発揮へ

千住金属工業は全事業部門が同じ取り組みや戦略を共有してシナジー効果を発揮させる「Trinity (三位一体) SMIC」をキーワードに、一段と事業展開を活性化、他社との差別化を図っている。

Trinity SMICとは、High Density、High Quality、High Total Cost of Ownershipの三つのカテゴリを示し、それぞれのソリューションを融合させてビジネスチャンスを拡大させる意図がある。1月に東京で開かれた「半導体パッケージング展」では、三つのカテゴリの中から戦略的な製品や技術を「Revolutionary Products」と明確に紹介した。さらに、一段高いステージが設けられ、30分に1回プレゼンテーションが行われた。



ステージも設けられた半導体パッケージング展でのブース

High Densityソリューションコーナーでは、凹凸部にも塗布できる3D用ソルダペースト「NXD90」

「RGSO」、0201チップ部品を実装できる「RGSI800Type6」、はんだ量の不足が予測されるランドにチップソルダ、フレキシブル基板の狭ピッチ実装用ハロゲンフリー極細線や入りはんだ、半導体パッケージ用はんだ材料を紹介。

High Qualityソリューションには、進化する車載用耐熱疲労性合金「M731/758/794」、耐

熱疲労性と耐落下衝撃性に優れるソルダボール「M758/770」、全ての部品からボイドを低減するソルダペースト「GLV」「GLV2」。

ipソリューションでは、弱体熱性のPETフィルムに高強度実装が可能なソルダペースト「L200JPP」、常温輸送と常温保管で温度管理の低減化を実現したソルダペースト「RTPシリーズ」、自動装置でのこて先食われを防止して差し替え頻度を減少させる合金「M84/86」などが紹介された。また、女性や高齢者に優しい「棒はんだ10μm包装仕様」の製品にも注目が集まった。先端はんだ材料追求「半導体、車載市場、ロボットはんだ付けなどで顧客のニーズはますます多様化する。蓄積した技術と革新技術によって、作業環境にも対応した先端のはんだ材料を追求していく」と同社は話している。